

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	景顺长城基金、博时基金、华夏基金、华西基金、东吴基金、博远基金、Kontiki Capital、中邮人寿保险、长城财富保险、太平养老保险、长城财富保险、中信资管、太平洋资管、华夏未来资管、上海七曜投资、上海弥远投资、上海青骊资理、上海峰岚资产、上海循理资产、北京金百镭投资、大家资管、深圳鑫然基金、广东正圆基金、复胜资产、上海贵源投资，浙商证券、财通证券、长江证券、天风证券、华创证券、中泰证券、华福证券、国投证券、中信证券、中信建投证券、民生证券、招商证券、东吴证券、国信证券、上海证券、华安证券、财信证券
时间	2024年4月28日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵，杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了民德电子2023年及2024年一季度财务情况，随后介绍了目前公司主要业务的发展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。</p> <p>一、公司财务情况介绍</p> <p>公司近几年在功率半导体方面持续投入较大，加之受半导体行业下行周期影响，短期财务数据方面出现一定下滑，但目前公司在功率半导体核心环节的各家企业均已投产，随着产能提升及行业回暖，公司的功率半导体业务有望进入快速增长期；条码识别升级为AiDC（Artificial Intelligence for Data Capture）事业部后，保持稳健增长的同时，市场竞争力大幅提升，毛利率也有所增加，继续为公司贡献稳定现金流。</p> <p>（一）2023年财务情况</p> <p>1、公司2023年实现营收4亿元，比2022年的5.18亿元减少了1.18亿元，同比下降了22.9%，主要原因有：</p>

(1) 全资子公司泰博迅睿收入同比减少了 1.5 亿元，一方面是因为对部分存在回款风险的客户未作收入确认，另一方面是对电子元器件分销业务客户进行调整，且电池业务市场需求低迷；(2) 控股设计公司广微集成，受 MOS 场效应二极管 (MFER) 仅依靠库存销售影响，收入同比减少约 2,000 万元；(3) 公司条码识别和自动分拣设备业务销售收入同比增加了约 5,000 万元。

2、2023 年归属于上市公司股东的净利润为 1,256 万元，同比减少了 7,613 万元，下降 86%，主要原因有：

(1) 参股的 3 家功率半导体生产企业，公司按权益法核算的长期股权投资收益降幅较大，其中：硅片公司晶睿电子，2023 年计入上市公司投资收益同比下降了 2,280 多万，同时 2022 年公司转让晶睿电子 2.0870% 股权的收益有 3,160 万元，晶睿电子一家对上市公司归母净利润影响超过 5,400 万元；晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克，在去年年末才开始小批量生产，尚未盈利，计入上市投资收益同比下降了 645 万元。

(2) 全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，且电池业务市场需求低迷；同时，由于个别电池客户存在回款风险，从审慎角度考虑，泰博迅睿未确认该部分合同收入并计提了跌价准备，导致净利润由盈转亏，对上市公司贡献的利润同比减少了约 2,500 万元。

(3) 控股设计公司广微集成，2023 年的场效应二极管产品仅能依靠库存维系数家核心客户业务，销售和利润均有所下滑，计入上市公司的利润同比减少约 690 万元。

(4) 2023 年公司条码和自动分拣设备业务收入和利润同比均有一定提升，为公司持续贡献现金流。

3、2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,748 万元，和归母净利润之间的差异主要是因为，泰博迅睿计提部分商誉减值，而泰博迅睿原股东需对减值金额进行补偿。

4、参股公司的长期股权投资收益，以及商誉减值，对公司的现金流不会造成影响。2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,766 万元，同比增长了 24%，公司经营状况保持稳定提升。2023 年年末，公司的总资产为 17.62 亿元，同比增加 15%；净资产为 11.66 亿元，同比增加了 1.78%。

(二) 2024 年第一季度财务情况

2024 年一季度，公司营业收入为 6,566 万元，较上年度减少 776 万元，下降 10.56%；归属于上市公司股东的净利润为 20 万元，较上年度减少 573 万元，下降 96.56%；主要原因有：

(1) 晶睿电子、广芯微、芯微泰克 3 家参股企业的利润同比下降明显，导致公司按权益法核算的长期股权投资收益同比减少约 900 万元。

(2) 公司条码识别业务依据保持稳健增长，一季度收入同比增长 13%，AiDC 事业部在细分赛道进展明显，数款应用于 IVD（体外诊断设备）行业的条码识别设备新品已开始小批量供货。

二、公司业务发展情况介绍

(一) AiDC 业务进展

2023 年底，公司将条码识别业务战略升级为 AiDC 事业部，致力于人工智能在数据采集领域的应用推广，基于 Ai+CIS 平台技术，不断丰富机器视觉类产品，服务于中国高端制造业的升级，赛道容量得到进一步拓宽。

公司于 2023 年底重点耕耘 IVD（体外诊断设备行业）细分市场，使用场景为 IVD 设备需要配置扫码设备来识读试管上的条码信息，该市场特点为：客户每年需求量稳定，行业龙头企业年采购额在数百万元以上，且伴随 IVD 国产替代趋势而持续增长；此外，扫码设备作为核心部件在 IVD 设备生命周期内一般不会轻易替换厂家；目前主要的 IVD 厂商使用的都是进口品牌扫码设备，且伴随 IVD 行业集采带来的行业降本压力，IVD 厂商普遍有设备核心零部件国产化降本诉求。

公司基于前期对数家行业龙头企业需求的调研，于近期推出了数款应用于 IVD 行业的条码识别设备新品，在为客户实现降本的同时，也解决了客户的一些痛点需求。新产品已在几家行业龙头企业测试验证中，目前测试效果反馈良好，部分客户已开始小批量采购。公司将积极推广新品在 IVD 行业的应用，有望在今年获得明显进展。

后续，公司将复制在 IVD 市场的开拓经验，在更多行业细分领域探索机器视觉类新产品和市场，与细分市场龙头企业深度合作、共同开发，推出更多具有极致性价比和差异化功能的新产品。

除此之外，公司今年还会重点拓展工业读码器领域，针对工业场景一些比较复杂的、识别难度较大的场景，例如复杂光线环境（反光、弱光等）、移动速度比较快的各种条码识别等，开发出更具优势的工业读码产品。

（二）功率半导体业务进展

公司经过 3 年多在功率半导体产业的投资建设期，随着晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克分别于去年 5 月和 12 月完成了投产通线，公司在功率半导体产业链核心环节企业均已步入量产阶段，功率半导体业务有望进入快速增长期。公司目前在功率半导体各环节进展的具体情况如下：

（1）晶圆代工厂广芯微电子

广芯微电子自 2023 年 12 月开始批量生产，目前 6 英寸产线的稳定产能已达到 5,000 片/月，预计今年年底达到 3 万片/月的稳定产能。广芯微电子目前的主要任务是将合作的几家设计公司的产品型号开发齐全，主要产品包括：广微集成的 MOS 场效应二极管，45-150V 全系列百余款产品已完成开发并开始批量生产，今年以来，广微集成已向广芯微电子下达超过 6,000 片的采购订单，后续将根据广芯微电子产能及市场情况持续下单；丽隼半导体的特高压 DMOS 系列产品，其工艺复杂、难度较大的 1,500V 特高压 DMOS 已开始批量生产，200V-1,200V 系列产品正在风险批验证阶段；熙芯微电子的高压 BCD 产品目前在进行工程批流片，争取二季度批量出货。

同时，广芯微电子于 2024 年 4 月顺利通过了 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证第一阶段审核，预计今年完成全部审核，以实现车规级功率器件产品的生产供应。

（2）设计公司广微集成

广微集成因 6 英寸晶圆代工产能迁移，MOS 场效应二极管（MFER）自 2022 年四季度开始一直以销售库存为主，广芯微电子在 2023 年 12 月成功量产 MFER 产品，广微集成 6 英寸晶圆代工产能成功迁移至广芯微电子。目前广微集成已完成 MFER 产品 45V-150V 全系列共一百余款型号的量产工作，并陆续给客户送样验证中，随着广芯微电子产能的快速提升，也将为广微集成今年的销售恢复提升奠定坚实基础。

广微集成在 12 英寸晶圆厂开发的分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，已量产 60V、80V、100V 系列产品，并在不断丰富量产系列产品型号，今年将根据市场情况启动更多新产品的开发工作。

（3）硅片原材料公司晶睿电子

受半导体市场低迷周期影响，晶睿电子 2023 年销量虽然有所增长，但是销售单价下滑明显，加上受 2023 年计提员工股权激励费用等影响，晶睿电子 2023 年毛利率和净利润同比下滑明显。自今年一季度以来，晶睿电子每月的外延片产量都在提升，目前基

本处于满产状态，订单充足。同时，晶睿电子的产品结构也发生了一些变化，硅外延片以前基本上是以6英寸为主，近期，8英寸外延片销量和占比在稳步快速提升，2024年一季度8英寸外延片销量已超过2023年全年数量总和；智能感知应用特种硅片月产量从2024年年初的2万片/月快速提升至目前的5万片/月，预计到年中可达到9万片/月；MEMS传感器用双抛片也已实现量产，SOI、SiC外延片等新品也在客户验证阶段；这些产品有望为晶睿电子带来新的增长。

(4) 超薄背道代工厂芯微泰克

芯微泰克于2023年12月正式投产通线，目前已有十多家客户在进行IGBT、SGT、特种功率及IC等产品的背道工艺试样验证，部分产品已开始小批量产出；预计到今年6月份芯微泰克月度投产的订单数量将达到5,000片规模，今年年底实现月产出1.5-2万片。芯微泰克一期产能建设规划为6英寸晶圆5万片/月、8英寸晶圆1.5万片/月。

以上是公司AiDC业务和功率半导体业务目前的一些具体进展。就2024年整体而言，AiDC业务的增速较之前预计会更快，给公司贡献更多的现金流；功率半导体业务将进入产能和业绩释放期。

三、问答交流

1、广微集成之前的代工厂有几家，分别有多少产能？目前的代工厂有几家，分别有多少产能？

答：广微集成目前主要有两类产品：6英寸的MOS场效应二极管(MFER)和12英寸的分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)，分别有一家代工厂。MFER在之前的代工厂产能最多的时候约1万片/月，代工厂切换到广芯微后，前期产能爬坡阶段广芯微电子的产能会优先满足广微集成需求，在广芯微电子满产状态下(6英寸代工产能13-14万片/月)约提供1/3的产能给广微集成；SGT-MOSFET的代工厂一直为同一家，广微集成已预订2,000片/月的产能，目前尚未满产，后续随着产品型号的完善和产量提升，广微集成也将和代工厂争取更多的产能和更优的价格。

2、功率半导体行业目前市场行情如何？

答：功率半导体市场已经历了两年的低迷期，从今年年初到现在来看，尤其是三四月份，硅片厂、晶圆厂和一些设计公司的订单在回暖，特别是硅片厂目前产销量提升明显。但目前市场价格尚未明显回调，和以前相比仍处于低位；如后面几个月时间，功率半导体产品能随着产量提升的同时，销售单价也有所提高，则说明功率半导体市场行情

的拐点可能真正到来。

3、条码业务在国内和海内外市场销售占比情况如何？

答：2023 年公司条码识别业务保持稳健发展，销售收入同比增长 17.58%，其中，海外销售增长显著，海外销售收入同比增长 47.51%，为公司贡献稳定的经营现金流。公司条码业务 2023 年和 2024 年一季度海外市场销售占比约 6 成，国内市场销售占比约 4 成。

4、公司 2024 年到目前启动了两次股份回购，回购的目的以及第二轮回购的进展？

答：公司回购股份主要是出于对自身价值的认可和保护投资者考虑。其中，公司第一轮 3,000 万元回购已完成，将全部予以注销，减少公司注册资本；第二轮 3,000-6,000 万元股份回购事项已经董事会审议通过，可以进行回购，目前暂未开始，后续的回购进展情况，我们也会根据深交所要求及时进行披露。

5、广芯微电子预计的订单是否能支撑起产能？

答：首先，广芯微电子前期将优先为公司 smart IDM 生态圈内的设计公司（广微集成、丽隼半导体、熙芯微电子）提供晶圆代工产能保障，上述设计公司在各自领域都有自己的特色产品，均已在广芯微电子投产，广微集成的 MOS 场效应二极管、丽隼半导体的高压 DMOS 已成功量产，熙芯微电子的高压 BCD 产品在进行工程批流片，上述设计公司的订单需求足以支撑起广芯微电子爬坡阶段的产能。此外，广芯微电子已经筛选并确定若干家技术能力优秀的功率器件设计公司作为一期产能代工客户。因此，广芯微电子下游客户需求可以支撑起产能。

6、公司的功率半导体下游终端客户都有哪些？

答：公司控股的功率半导体设计公司广微集成，由于目前体量较小，主要还是以销售半成品晶圆片给品牌封装厂为主，暂时没有直接面向终端客户。据了解，广微集成的产品主要应用在光伏接线盒、储能 BMS、电源适配器、工业 PFC 等场景。后续，随着广微集成产能的不断提升，也将陆续推出封装成品，产品将坚持面向进口替代，面向工业和能源市场。

7、公司碳化硅业务的进展及布局情况？

答：公司在碳化硅器件领域是基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。目前，外延片制造厂晶睿电子的碳化硅外延片在客户验证阶段，晶圆代工厂广芯微电子的碳化硅晶圆加

	<p>工线已在进行安装调试，超薄片背道代工厂芯微泰克也将为客户提供碳化硅器件超薄片背道加工服务；芯片设计公司广微集成、丽隼半导体等 smart IDM 生态圈内企业，均有碳化硅器件产品量产经验，技术储备丰富。公司坚持以硅基器件为基本盘，来拓展碳化硅器件。在这种情况下，相较于其它只做碳化硅产品的厂商，从固定资产折旧摊销角度，公司碳化硅器件产品成本方面会具有更大的优势。</p> <p>8、公司控股收购广芯微电子股权的进展情况？对广芯微电子剩余股权的规划？</p> <p>答：目前公司已分别与丽水市绿色产业发展基金有限公司签署了广芯微电子 9.8361% 的股权收购协议，以及丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司签署了广芯微电子 0.9197% 的股权收购协议，协议在执行过程中；以招拍挂的形式参与收购丽水市绿色产业发展基金有限公司持有的广芯微电子剩余 4.9180% 股权事项，目前政府方面正在开展招拍挂前期工作，正式的招拍挂流程尚未开始；预计整个交易会在 2024 年年底完成。上述交易全部完成后，公司将持有广芯微电子 50.1% 的股权，届时上市公司对广芯微电子将实现并表。对于广芯微电子剩余股权，后续我们将根据广芯微电子的发展情况再和各方沟通协商，目前暂时没有明确的规划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-04-28